

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2026-018

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行

并上市申请的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司已于2025年9月28日向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司已于2026年4月1日向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。

鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108394/documents/sehk26040104298_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108394/documents/sehk26040104299.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。

公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构的批准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规以及本次发行并上市的相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026年4月2日